

2022-2028年中国半导体用 环氧塑封料(EMC)行业发展态势与市场供需预测报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2022-2028年中国半导体用环氧塑封料(EMC) 行业发展态势与市场供需预测报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202110/244059.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

中企顾问网发布的《2022-2028年中国半导体用环氧塑封料(EMC)行业发展态势与市场供需预测报告》共八章。首先介绍了半导体用环氧塑封料(EMC)行业市场发展环境、半导体用环氧塑封料(EMC)整体运行态势等，接着分析了半导体用环氧塑封料(EMC)行业市场运行的现状，然后介绍了半导体用环氧塑封料(EMC)市场竞争格局。随后，报告对半导体用环氧塑封料(EMC)做了重点企业经营状况分析，最后分析了半导体用环氧塑封料(EMC)行业发展趋势与投资预测。您若想对半导体用环氧塑封料(EMC)产业有个系统的了解或者想投资半导体用环氧塑封料(EMC)行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章环氧塑封料产品概述

- 1.1环氧塑封料产品定义
- 1.2环氧塑封料的发展历程与产业现状
- 1.3环氧塑封料技术发展趋势
- 1.4环氧塑封料在半导体产业中的重要地位

第二章环氧塑封料的组成、品种分类及生产过程

- 2.1环氧塑封料产品组成
- 2.2环氧塑封料产品品种分类
 - 2.2.1以分立器件封装和集成电路封装两类分类
 - 2.2.2以EMC所采用的环氧树脂体系分类
 - 2.2.3以芯片封装外形以及具体应用分类
 - 2.2.4以EMC的不同性能分类
- 2.3环氧塑封料制作过程
- 2.4环氧塑封料产品性能
 - 2.4.1未固化物理性能
 - 2.4.2固化物理性能

2.4.3机械性能

第三章环氧塑封料的应用及其主要市场领域

3.1IC封装的塑封成形工艺过程

3.1.1IC封装塑封成形的工艺过程

3.1.2IC封装塑封成形的工艺要点

3.1.3IC封装塑封成形的质量保证

3.2环氧塑封料的应用领域

3.2.1分立器件封装

3.2.2集成电路封装

第四章全球半导体封测产业概况及市场分析

4.1世界半导体封装业发展特点

4.2世界半导体封装产品的主要生产制造商

4.3世界半导体封装业的发展现状

4.3.12019年世界半导体产业与市场概况

4.3.2世界封测产业与市场概况

4.4世界封测产业的发展总趋势

4.5世界封测产值统计

第五章我国半导体封测产业概况及市场分析

5.12019年我国半导体产业发展状况

5.2我国集成电路封测业发展现状

5.2.1我国集成电路产业发展

5.2.2我国集成电路封测产业发展现状

5.2.2.1我国IC封测产业市场规模现状

5.2.2.2我国IC封测厂家分布及产能

5.2.2.3我国IC封测业的骨干生产企业情况

5.2.2.4我国IC封测业内资企业在近期的技术发展

5.3我国半导体分立器件封测业发展现状

5.3.1我国半导体分立器件生产现状

5.3.2我国半导体分立器件行业发展特点

5.3.3我国半导体分立器件产业地区分布及市场结构

5.3.4我国半导体分立器件生产厂家情况

5.3.5我国半导体分立器件市场发展前景

第六章世界环氧塑封料产业的生产与技术现状

6.1世界环氧塑封料生产与市场总况

6.2世界环氧塑封料主要生产企业概述

6.3日本环氧塑封料生产厂家现状

6.3.1住友电木 (SumitomoBakelite)

6.3.2日东电工 (NittoDenko)

6.3.3日立化成 (HitachiChemical)

6.3.4松下电工株式会社 (MatsushitaElectric)

6.3.5信越化学工业 (Shin-EtsuChemical)

6.3.6京瓷化学 (KyoceraChemical)

6.4台湾环氧塑封料生产厂家现状

6.4.1长春人造树脂

6.4.2台湾其它环氧塑封料生产厂家现状

6.5韩国环氧塑封料生产厂家现状

6.5.1韩国环氧塑封料生产厂家情况总述

6.5.2三星集团第一毛织

6.5.3韩国KCC

6.6欧美塑封料生产厂家现状

6.6.1汉高集团 (Hysol)

6.6.2欧美其它环氧塑封料生产厂家现状

第七章我国环氧塑封料产业现状及国内市场需求

7.1我国环氧塑封料业的发展现状

7.2我国环氧塑封料业生产企业情况

7.3我国环氧塑封料业技术水平现况

7.3.1国内不同性质企业的EMC产品水平分析

7.3.2国内不同性质企业的EMC技术与产品结构现况

7.3.3国内不同性质企业在EMC产品与技术研发能力的现况

- 7.4我国国内环氧塑封料的市场需求情况
- 7.5未来几年我国环氧塑封料行业的发展趋势预测
- 7.6我国环氧塑封料的主要生产厂家情况
 - 7.6.1汉高华威电子有限公司
 - 7.6.2长兴电子材料(昆山)有限公司
 - 7.6.3住友电木(苏州)有限公司
 - 7.6.4日立化成工业(苏州)有限公司
 - 7.6.5北京首科化微电子有限公司
 - 7.6.6佛山市亿通电子有限公司
 - 7.6.7浙江恒耀电子材料有限公司
 - 7.6.8江苏中鹏电子有限公司
 - 7.6.9江苏晶科电子材料有限公司
 - 7.6.10广州市华塑电子有限公司
 - 7.6.11松下电工(上海)电子材料有限公司
 - 7.6.12北京中新泰合电子材料科技有限公司
 - 7.6.13长春封塑料(常熟)有限公司
 - 7.6.14无锡创达电子有限公司
 - 7.6.15广东榕泰实业股份有限公司

第八章环氧塑封料生产主要原材料及其需求

- 8.1EMC用环氧树脂()
 - 8.1.1EMC对环氧树脂原料的要求
 - 8.1.2世界及我国环氧树脂业发展现状
 - 8.1.3国内环氧树脂产业的原材料供应情况
 - 8.1.3.1双酚A
 - 8.1.3.2环氧氯丙烷(ECH)
 - 8.1.4绿色化塑封料中的环氧树脂开发情况
- 8.2EMC用硅微粉
 - 8.2.1EMC对硅微粉原料的要求
 - 8.2.2EMC用硅微粉产品概述
 - 8.2.3国外EMC用硅微粉产品生产的现况
 - 8.2.3.1日本EMC用硅微粉的生产现况()

8.2.3.2北美EMC用硅微粉的生产现况

8.2.3.3欧洲EMC用硅微粉的生产现况

8.2.4国内EMC用硅微粉产品生产的现况

部分图表目录：

图表1：2019年中国GDP

图表2：2015-2019年国内生产总值及其增长速度

图表3：2019年居民消费价格月度涨跌幅度

图表4：2019年居民消费价格比上年涨跌幅度

图表5：2019年按收入来源分的全国居民人均可支配收入及占比

图表6：2015-2019年全部工业增加值及其增长速度

图表7：2019年主要工业产品产量及其增长速度

图表8：2015-2019年全国一般公共预算收入

图表9：2015-2019年全年社会消费品零售总额

图表10：2015-2019年货物进出口总额

图表11：2019年货物进出口总额及其增长速度

图表12：2019年主要商品出口数量、金额及其增长速度

图表13：2019年主要商品进口数量、金额及其增长速度

图表14：2019年对主要国家和地区货物进出口额及其增长速度

图表15：2019年中国固定资产投资

图表16：2015-2019年全社会固定资产投资

图表17：2019年分行业固定资产投资（不含农户）及其增长速度

图表18：2019年固定资产投资新增主要生产与运营能力

图表19：环氧塑封料产品组成

图表20：IC封装塑封成形的工艺过程

图表21：封装技术应用领域及代表性封装型式

图表22：2015-2019年全球半导体封测产值分析

图表23：2015-2019年我国集成电路行业增长情况

图表24：2019年我国集成电路出口情况

图表25：2019年集成电路产业内销产值增长情况

图表26：2015-2019年我国集成电路固定资产投资增长情况

图表27：2019年我国集成电路行业经济效益增长情况

更多图表见正文……

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202110/244059.html>